

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 26 年 7 月 17 日 (2014.7.17)

【公開番号】特開 2013-161863 (P2013-161863A)
 【公開日】平成 25 年 8 月 19 日 (2013.8.19)
 【年通号数】公開・登録公報 2013-044
 【出願番号】特願 2012-20829 (P2012-20829)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/301 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/78 Q

H 0 1 L 21/304 6 0 1 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 26 年 5 月 30 日 (2014.5.30)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

外周端部に厚肉部を、中央部に薄肉部を有する半導体ウエハを準備する工程と、
 前記半導体ウエハの一方の面に支持部材を装着する工程と、
 前記支持部材の装着後に、前記半導体ウエハを前記厚肉部と前記薄肉部とに分割する工程と、

前記分割後に、前記支持部材で前記薄肉部を支持した状態で前記薄肉部を切断する工程と、を備える、半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

前記分割後に前記厚肉部を前記支持部材から分離する工程をさらに備える、請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

前記支持部材は粘着テープを含み、
 前記粘着テープは、前記薄肉部から前記厚肉部にわたって貼付られる、請求項 1 または請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

前記厚肉部を、前記粘着テープから分離する前に、前記厚肉部と接する部分における前記粘着テープの粘着力を低下させる工程を備える、請求項 3 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 5】

前記厚肉部を前記支持部材から分離した後に、
 前記支持部材を伸張させる工程をさらに備える、請求項 2 ～請求項 4 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 6】

前記厚肉部を直接保持して分離する、請求項 2 ～請求項 5 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 7】

前記厚肉部を真空吸着することにより保持する、請求項 6 に記載の半導体装置の製造方

法。

【請求項 8】

前記厚肉部を静電吸着することにより保持する、請求項6に記載の半導体装置の製造方法。